

Platzierungsbeginn: 1. Februar 2012

Hauptaussteller (Korrespondenz- und Rechnungsadresse)

Firma

Ansprechpartner

Halle/Stand-Nr.

Frau
Herr

Straße / Postfach

Staats-Kennz. / PLZ Ort

Hiermit autorisieren wir das unten stehende Unternehmen, als Mitaussteller auf unserem Stand auszustellen.

Die Firma ist im Besitz aller zur Unterrichtung von Ausstellungsbesuchern notwendigen technischen und kommerziellen Unterlagen über die gezeigten Exponate. Die Exponate entsprechen dem Warenverzeichnis (vgl. allgemeine Teilnahmebedingungen A 4).

Bitte beachten Sie den Paragraphen B 3 „Mitaussteller und zusätzlich vertretenes Unternehmen“ und B 4 b) „Obligatorischer Kommunikationsbeitrag“.

Gebühr je zugelassenen Mitaussteller 200,- EUR
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag 280,- EUR

Mitaussteller zusätzlich vertretenes Unternehmen

Firma

Straße

Postleitzahl Ort

Land

Umsatzsteuer-Id-Nr. (Pflichtangabe laut Umsatzsteuergesetz)

Nr. und Ort der Handelsregistrierung

E-Mail (personalisiert)

Homepage

Hersteller Händler Importeur Vertriebsgesellschaft mit alleinigem Verkaufsrecht für Deutschland

(Mehrfachnennung möglich)

Dienstleistungsunternehmen Mitglied folgender Fachverbände: _____

Anmelder, die in Deutschland oder in der Europäischen Union ansässig sind: Bei dem Anmelder handelt es sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbstständig ausübt (Art. 9 MwStSystRL). Der Anmelder erklärt hiermit, die Leistungen der Messe München GmbH für sein Unternehmen zu beziehen.

Anmelder, die in einem Land außerhalb der Europäischen Union ansässig sind: Bei dem Anmelder handelt es sich um ein Unternehmen, das eine wirtschaftliche Tätigkeit zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen selbstständig ausübt (Art. 9 MwStSystRL). Der Anmelder erklärt hiermit, die Leistungen der Messe München GmbH für sein Unternehmen zu beziehen.

Keine der oben stehenden Erklärungen ist zutreffend. In diesem Fall wird die Messe München GmbH ihre Leistungen selbst dann zuzüglich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer berechnen, wenn der Anmelder im Ausland ansässig ist.

Ansprechpartner/-in für Messeorganisation Titel/Vorname/Nachname

Frau
Herr

Telefon mit Vor- und Durchwahl Fax

Position

E-Mail (personalisiert)

Bitte auf Warengliederung/Angebotsschwerpunkte ankreuzen, in welche Warengruppe Ihre Produkte gehören

Bitte ändern Sie die Korrespondenz- und Rechnungsadresse auf den Mitaussteller ab. Die vom Mitaussteller bei der Messe München bestellten Leistungen sollen auch direkt an den Mitaussteller berechnet werden.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen A und B sowie die Technischen Richtlinien.

Die mit den Anmeldeunterlagen des Hauptausstellers zugesendeten Teilnahmebedingungen A und B sowie die Technischen Richtlinien werden zur Kenntnis genommen und hiermit rechtsverbindlich anerkannt. Jeder in fremdem Namen handelnde Anmelder verbürgt sich hiermit selbstschuldnerisch für die Forderungen der MMG anlässlich der obigen Messe.

Bitte beachten:

Ihre hier gemachten Angaben dienen dazu, Ihren Stand auf der LOPE-C optimal zu platzieren. Sollten Sie Exponate in mehr als einer Hauptgruppe der Warengliederung zur Ausstellung bringen, markieren Sie bitte den bevorzugten Angebotsschwerpunkt, in dessen Bereich Ihr Messestand platziert werden soll.

Bitte einsenden an:

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Deutschland

Projektleitung LOPE-C

Hauptaussteller

Firma

Halle/Stand-Nr.

--	--

Mitaussteller/zusätzlich vertretenes Unternehmen

Firma

--

Warengliederung / Angebotsschwerpunkte LOPE-C 2012 – Mitaussteller

Bitte kreuzen Sie nur einen Angebotsschwerpunkt an, in dem Ihr Unternehmen sein Hauptgeschäftsfeld hat.

1. Materialien und Komponenten

1.1 Substrate (Druckträger)

- 1.1.1 Plastikfolien
- 1.1.2 Blattmetall
- 1.1.3 Papier
- 1.1.4 Glas
- 1.1.5 Textilien
- 1.1.6 Sonstige Substrate

1.2 Leitende Materialien

- 1.2.1 Organische Materialien
- 1.2.2 Anorganische Materialien
- 1.2.3 Nano-Materialien
- 1.2.4 Carbon Nanotubes
- 1.2.5 Hybride Leiter

1.3 Halbleiter

- 1.3.1 Halbleiter
- 1.3.2 Polymere
- 1.3.3 Kleinstmolekülhalbleiter
- 1.3.4 Anorganische Halbleiter
- 1.3.5 Nanohalbleiter
- 1.3.6 Hybride Halbleiter

1.4 Dielektrika

- 1.4.1 Organische Dielektrika
- 1.4.2 Anorganische Dielektrika
- 1.4.3 Nano-Materialien
- 1.4.4 Carbon Nanotubes
- 1.4.5 Hybride Dielektrika

1.5 Verkapselungs-Materialien und Kleber

- 1.5.1 Dünnschicht-Verkapselung
- 1.5.2 Polymer-Verkapselung
- 1.5.3 Metall-Verkapselung
- 1.5.4 Glas-Verkapselung
- 1.5.5 Kleber

1.6 Komponenten für hybride Systeme (Polytronics)

1.7 Sonstige Materialien

2. Herstellungsverfahren und -technik

2.1 Massendruckverfahren

- 2.1.1 Tiefdruck
- 2.1.2 Offset-Druck
- 2.1.3 Flexodruck
- 2.1.4 Siebdruck

2.2 Digitale Druckverfahren

- 2.2.1 Inkjet
- 2.2.2 Andere digitale Druckverfahren

2.3 Sonstige Druckverfahren

- 2.3.1 µCP
- 2.3.2 Nanoprägelithografie
- 2.3.3 Sonstige Druckverfahren

2.4 Vakuumprozesse

- 2.4.1 Evaporation
- 2.4.2 Sputtering
- 2.4.3 Organic vapor phase deposition (OVPD)

2.5 Fotolithografie

- 2.6.1 Laser Ablation
- 2.6.2 Laser Transfer

2.7 Beschichtungsverfahren

- 2.7.1 Rotationsbeschichtung (Spin coating)
- 2.7.2 Tauchbeschichtung (Dip coating)
- 2.7.3 Rakelbeschichtung (Blade Coating)
- 2.7.4 Sonstige Beschichtungsverfahren

2.8 Verkapselungstechnik

- 2.8.1 Dünnschicht-Verkapselung
- 2.8.2 Polymer-Verkapselung
- 2.8.3 Metall-Verkapselung
- 2.8.4 Glas-Verkapselung
- 2.8.5 Sonstige Verkapselungstechniken

2.9 Reinraumtechnik

2.10 Rolle-zu-Rolle-Verfahren

2.11 Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken

Hauptaussteller

Firma

Halle/Stand-Nr.

--	--

Mitausteller/zusätzlich vertretenes Unternehmen

Firma

--

Bitte kreuzen Sie nur einen Angebotsschwerpunkt an, in dem Ihr Unternehmen sein Hauptgeschäftsfeld hat.

3. Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration

3.1 Elektrische Verbindungstechnik

- 3.1.1 Flip Chip
- 3.1.2 Sonstige Verbindungstechniken
- 3.2 Laminierung**
- 3.3 Systemintegration**
- 3.4 Hybride Systeme (Polytronik)**

4. Inspektions- und Testsysteme

- 4.1 Elektrische Charakterisierung**
- 4.2 Physikalische/Optische Charakterisierung**
- 4.3 Chemische Charakterisierung**
- 4.4 Simulation/Schaltkreisoptimierung**
- 4.5 Lebensdauer Test**
- 4.6 Qualitäts-/Prozesskontrolle**
- 4.7 Umweltprüfverfahren**
- 4.8 Sonstige Inspektions- und Testsysteme**

5. Bauelemente/Geräte

- 5.1 Transistoren**
- 5.2 Dioden**
- 5.3 Passive Bauelemente**
 - 5.3.1 Kondensatoren
 - 5.3.2 Widerstände
 - 5.3.3 Sonstige passive Bauelemente
- 5.4 Integrierte Schaltkreise**
- 5.5 Displays**
 - 5.5.1 OLEDs
 - 5.5.2 Elektrophoretische Displays
 - 5.5.3 Elektrochrome Displays
 - 5.5.4 Elektrolumineszenz-Displays
 - 5.5.5 LCDs
 - 5.5.6 Displays mit Elektrobenetzung (Electrowetting)
 - 5.5.7 Sonstige Displays
- 5.6 Fotovoltaikzellen**
 - 5.6.1 Organische Photovoltaikzellen
 - 5.6.2 Hybride Photovoltaikzellen
 - 5.6.3 Anorganische Photovoltaikzellen

5.7 Sensoren

- 5.7.1 Fotodioden
- 5.7.2 Drucksensoren
- 5.7.3 Temperatursensoren
- 5.7.4 Gassensoren
- 5.7.5 Sonstige Sensoren
- 5.8 Speicherbausteine**
- 5.9 Antennen**
- 5.10 Batterien**
- 5.11 Sonstige Bauelemente**

6. Anwendungen

- 6.1 RFID**
- 6.2 TFT Backplanes**
- 6.3 Displays**
- 6.4 Sensoren**
- 6.5 Intelligente Bausteine**
- 6.6 Solarzellen**
- 6.7 Intelligente Textilien**
- 6.8 Lautsprecher**
- 6.9 Beleuchtung**
- 6.10 Sonstige Anwendungen**

7. Dienstleistungen und Services

- 7.1 Consulting**
- 7.2 F&E Förderprogrammmanagement**
- 7.3 Forschung & Entwicklung**
- 7.4 Prototypenentwicklung**
- 7.5 Auftragsfertigung**
- 7.6 Kapital- und Risikobeteiligungsformen**
- 7.7 Fachvereinigungen und -verbände**
- 7.8 Fachbücher, Fachzeitschriften, Fachverlage**